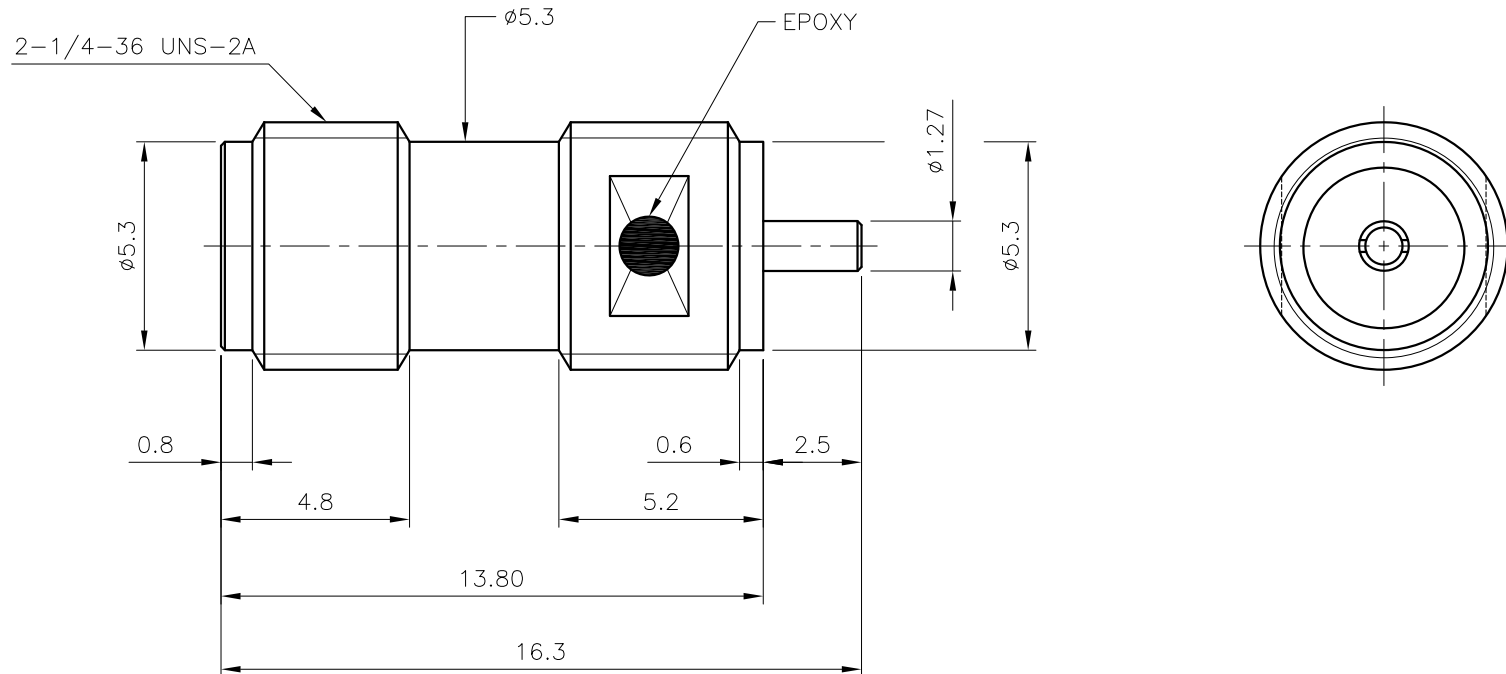


* ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 50ohm
2. FREQUENCY RANGE : DC~12GHz
3. VSWR : 1.2 (Max)

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2023.10.25.



■ 조립 순서

1. 바디 + 절연체 조립
2. 1번 조립품 ,바디 Ø1.5 HOLE 부위에 DRILL 관통 작업
3. 핀 조립 -> EPOXY 작업 진행

■ 주의사항

1. EPOXY 작업 진행 시 나사산 타고 흐르지 않도록 주의할 것
2. EPOXY 작업 완료 후 NUT 체결하여 통과하는지 필히 확인할 것
3. 체결이 원활하지 않은 것은 뾰족한 공구를 이용하여 예폭시 띄어낸 후 재검사 할 것

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN03375-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate (1.27μm)	DCT04404-5/1
1	BODY	1	SUS304	Passivate	DBD04918-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.1	DATE 2023. 10. 25.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°	APPROVED BY			
MATERIAL _____		CHECKED BY	TITLE SMA50 SOLDER END JB (F/F)		
		DRAWN BY			
FINISH _____	SCALE 5/1	UNIT mm		A4	DWG NO. CN04065-7/2
					REVISION I R